

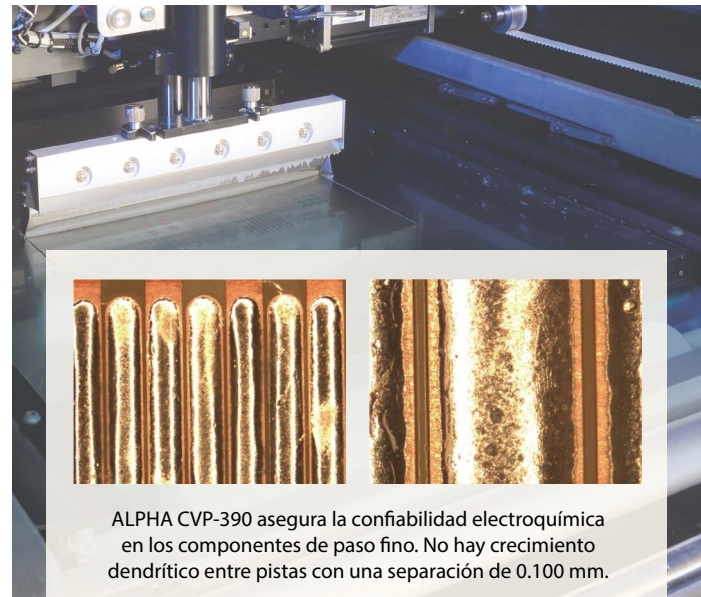
ALPHA[®] CVP-390

Soldadura en pasta que no necesita limpiarse, sin plomo y con cero halógenos

La mejor confiabilidad electroquímica y capacidad para las pruebas de pines en su clase

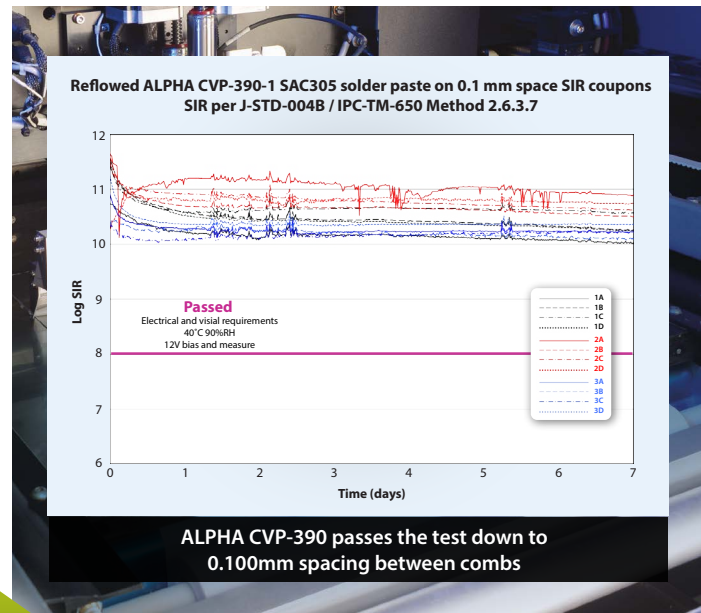
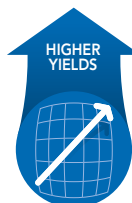
ALPHA CVP-390 es una soldadura en pasta que no necesita limpiarse, sin plomo y con cero halógenos que además es compatible con diversas aleaciones y está diseñada para aplicaciones de alta confiabilidad, donde se requiere de confiabilidad electroquímica y excelente capacidad para las pruebas de pines. Su repetibilidad del depósito de volumen de impresión superior en todas las proporciones de área (area ratios) proporciona valor, ya que reduce los defectos asociados con la variabilidad del proceso de impresión. Entre los procesos de ensamble que pueden beneficiarse de ALPHA CVP-390 están:

- Ensamblajes para los que se requiere de flexibilidad en múltiples tipos de componentes.
- Aplicaciones de alta confiabilidad para las que se requiere de excelente confiabilidad electroquímica en componentes de paso fino.
- Ensamblajes para los que se requiere de capacidad de impresión de características finas y mayor rendimiento de producción.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La excelente confiabilidad electroquímica en espacios de hasta 0.100 mm en retadores perfiles condensados de tipo automotriz.
- Amplia ventana de proceso de reflujo con capacidad de remojo de 175 a 180 °C durante 60 segundos.
- Coalescencia en depósitos de pasta de 180 µm.
- Reducción de los defectos de contacto intermitente (Head-in-Pillow).
- Supera los huecos del IPC 7905 Clase III para el perfil de remojo y baja formación de huecos en depósitos de áreas grandes.
- Compatible con aleaciones SAC305, SACX[®] Plus de baja plata y aleaciones Innolot de alta confiabilidad.

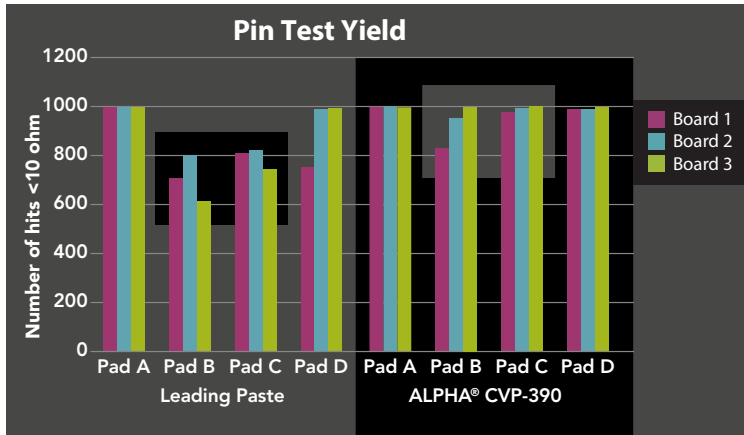


alpha

* El término "con cero halógenos" se define como ningún halógeno agregado intencionalmente a la formulación.

ALPHA[®] CVP-390

Soldadura en pasta que no necesita limpiarse, sin plomo y con cero halógenos



ALPHA CVP-390 ofrece:

- ✓ Excelente capacidad de impresión de características finas
- ✓ Alta confiabilidad electroquímica
- ✓ Mayor rendimiento operativo al tiempo que mejora la confiabilidad
- ✓ Menos retrabajo

RESUMEN DE DESEMPEÑO

PROCESS BENEFITS	PROPERTIES	PERFORMANCE CAPABILITIES
Print Process Window	Fine feature print definition	Excellent print definition and consistent volumetric performance to 0.3mm (12 mil) <ul style="list-style-type: none"> • down to 180µm (8mil) diameter • 0.4mm (16mil) pitch QFP • Min area ratio of 0.6
	Temperature window	Capable of printing in temperatures form 20-32°C (68-90°F)
	Tack/stencil life	Long stencil life of at least 8 hours of continuous printing
	Squeegee pressure	0.21-0.36 kg/cm of blade
	Print speed range	Wide process window from 25-150mm/sec (1-6"/sec)
Reflow Yield	Peak reflow temperature	235 to 245°C (optimal recommended: <240°C)
	Resistance to voids	Meet IPC 7905 Class III requirements
	Resistance to cold and hot slump	Preferred J-STD-004A and JIS Level 2
	Flux residue cosmetics	Clear
	Solder spread	80%
	Random solderballs	Preferred J-STD-004A and JIS Level 2
	Flux residue characteristics	Pin testable and passes JIS Cu corrosion test
Electrical Reliability	SIR	Meets/exceeds JIS, J-STD-004B and Bellcore requirements, and automotive damp heat profiles.
	Electromigration resistance	Meets/exceeds JIS, Bellcore
	Halide content	Halide free
	J-STD-004B classification	ROLO
Environmental	Halogen content	Zero-Halogen, no halogen intentionally added



macdermidalpha.com

July 2020

Alpha es una marca de producto de MacDermid Alpha Electronics Solutions.

For more information, contact us at Assembly@MacDermidAlpha.com

© 2020 MacDermid, Inc. and its group of companies. All rights reserved.

® and ™ are registered trademarks or trademarks of MacDermid, Inc. and its group of companies in the United States and/or other countries.